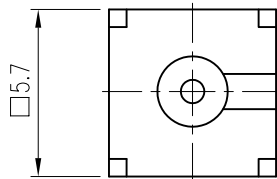
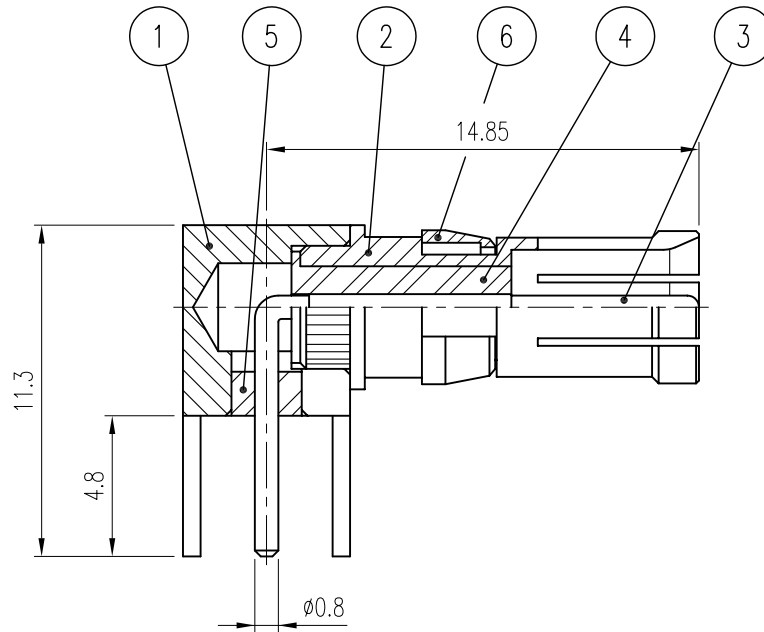


ST	수정내역									
	부호	내용	수정자	승인자	년	월	일			
ST(기준)										
ST(개선)										



6	SPRING RING	1	BeCu	Nickel Plate	DSR00031-1345/1 (RB001)
5	INSULATOR	1	TEFLON		(HB037)
4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00877-N/1 (HB036)
3	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT00959-135/1 (EB026)
2	BODY	1	BeCu	Gold Plate	DBD01176-1345/1 (DB047)
1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD01170-135/1 (DB046)

대체가능재질	품번	품 명		수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일	1996. 7. 11.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.		
	승인						
	재질	검도				도명 CONNECTOR	
열처리	재도						
보호피막처리	작성부서			연 구 소			
	적도	4/1	단위				mm
					A4	도번	CN00656-7/1
							K385-533-001